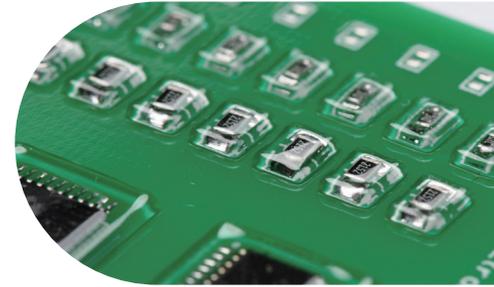


KP400

KÖNIG
康尼格

回路基板
デジタル化パッケージングデバイス



ピクセルレベル全域処理技術

2D単層画像印刷 | 3D多層立体成形

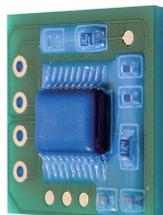


多様なパッケージ保護モデル

ディスペンサー、コーティング、封入する。1台の設備で様々な種類やレベルの防護が実現できます。



薄層塗装
一般防護



厚塗り塗装
高レベル鎧保護



フェンス+塗りつぶし
同じタイプUVジェル



単独フェンス
任意の接着剤を充填する



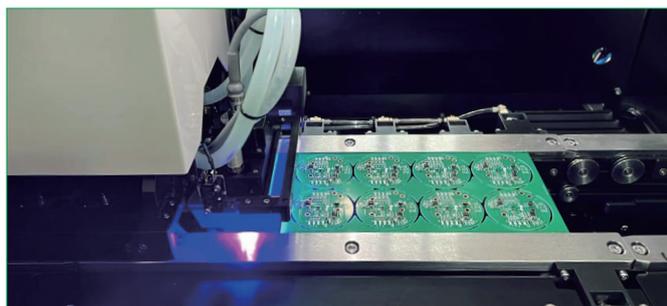
生態系のハイライト：スプレー印刷により精密な選択性保護を行い、接着剤の浪費を減少する、UV Ledはすぐに固まり、溶媒の揮発がなく、環境に優しい。

KP400

全領域処理ロジック | アレイヘッド | マスキング工程不要

設備概要

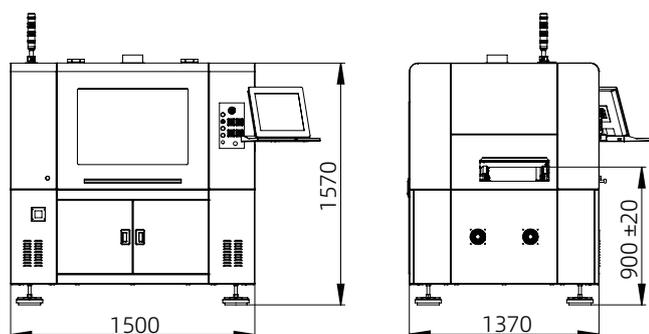
KP400 は 3D 印刷技術を電子パッケージ保護分野に応用し、新しい概念の製品パッケージ保護装置である。UV 接着剤を防護が必要な領域まで正確に噴射し、多層積層により各種の 3D 形態を形成し、PCBA、FPC などの電子部品に高強度の保護を提供する。



工業級圧電ヘッド、高信頼性3軸運動プラットフォーム



高精度CCD測位システム、双頭水冷UV-LED硬化システム



パッケージの厚さ/速度	パラメータ	備考
単層パッケージ厚さ	15/30/50 μm	調整可能
多層パッキング厚さ	3 mm	多層スタックの総厚み
最速の単層カプセル化時間	15 s	320*400 mm
軸速度		
運動軸数	3	
移動速度 (XY)	200 or 300 or 400 mm/s	低/中/高速
精度		
カプセル化精度	±0.1 mm	
重複精度	±0.02 mm	
作業範囲		
X軸とY軸方向の最大有効作業面積	400*320 mm	
最大負荷	3 kg	
PCBA特性		
最大サイズ	400*320 mm	
構成部品の最大高さ	がおすすめ≤10 mm	
システム制御		
ソフトウェアシステム	KP400 Smart Software	自主知的所有権IPR
Windowsオペレーティングシステム	Win10	
電源装置		
電源装置	220V/ 50Hz/ 3kW	
圧縮空気	0.5Mpa以上	
環境温度範囲	17-28°C	
相対空気湿度	30-70%RH	
設備サイズ		
寸法(長さx幅x高さ)	1500*1370*1570 mm	
重量	1250 kg	
主要部品		
ノズル	工業用圧電ノズル*	
ドライブモーター (XY/ZR)	XY軸リニアモーター/ZR軸ステッピングモーター	
接着剤硬化システム	双頭UV LED、水冷タイプ	
視覚測位システム	500 W産業用カメラ、高精度遠心レンズ	
グルーミングシステム	独立二重循環せちやくろ	
トランスファシャフト	精密ラッピングネジ	
軌道データ		
搬送面の最大高さ	上25 mm 下80 mm	
開閉速度	30 mm/s	
輸送高さ	900±20 mm or 1000±20 mm	
輸送速度	5-10 m/min	
コンベアベルトタイプ	耐熱・静電気防止ベルト	
輸送方向	L→R (R→L構成の選択)	
PCBエッジ空間	≥5 mm	

適用材料特性	
ざいりょうねんど	10-15cps (動作温度30°C~55°C)
材料シート	25-35dyn/cm
PH値	6-8
りゅうけい	D90 ≤ 200 nm
こうかほうしき	UV硬化

* 材料はコニグ試験に合格してから機械に乗せて使用することができ、そうしないと設備の接着剤路やノズルに損傷を与えることがあります。

蘇州康尼格電子科技株式有限公司

住所：中国江蘇省常熟市辛庄鎮長盛路33号

T +86-512-5247 9018 | F +86-512-5247 9098 | E info@konig.hk

KONIG JAPAN

851-1, TSUGEBABA-CHO, NARA-CITY NARA, 632-0113, JAPAN

T. 090-8482-2509 | M. kunikawa.seitaro@konig.hk



KONIG Website